

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

截至二零二六年九月三十日止三個月之 二零二六年第三季度未經審核業績公布

集團新增訂單總額創新高 SEMI 及 SMT 分部盈利均表現強勁

關鍵亮點

- ✱ 受 TCB、表面貼裝技術解決方案分部業務及光子帶動，集團新增訂單總額創新高
- ✱ 來自人工智能數據中心的強勁需求推動 TCB 晶片到基底的新增訂單創新高
- ✱ 光子保持增長勢頭，新增訂單總額及銷售收入均創新高
- ✱ 受表面貼裝技術解決方案分部及半導體解決方案分部帶動，經調整毛利率上升至 42.9%
- ✱ 銷售收入及經調整每股基本盈利均勝市場預期

集團財務概要

(港幣百萬元)	二零二六年第三季度	按季	按年
		持續經營業務¹	
新增訂單總額 ²	8,845.1 (11.28 億美元)	+24.7%	+137.9%
銷售收入	5,247.0 (6.69 億美元)	+6.3%	+48.7%
毛利率	42.1%	-29 點子	+661 點子
經營利潤	798.6	+1.5%	+890.9%
盈利	533.2	+27.6%	NM
每股基本盈利	港幣 1.28 元	+26.7%	NM
		持續經營業務¹之非香港財務報告會計準則計量³	
經調整毛利率	42.9%	+35 點子	+517 點子
經調整經營利潤	922.4	+8.9%	+379.2%
經調整盈利	689.7	+8.2%	+486.3%
經調整每股基本盈利	港幣 1.65 元	+7.8%	+489.3%

NM: 無意義

二零二六年第四季度銷售收入預測

- ✱ 將介乎 6.7 億美元至 7.3 億美元之間，以其中位數 7.0 億美元計按季上升 4.6%，按年亦上升 37.5%

¹ 出售 ASMPT NEXX, Inc. (「NEXX」) 事項已於二零二六年六月三日交割。於交割後，NEXX 已不再為本公司之附屬公司

² 新增訂單總額反映該季度內新取得的訂單

³ 有關上述非香港財務報告會計準則計量之詳情，請參閱本業績公告之「香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬」一節

ASMPT Limited 董事會欣然宣布集團截至二零二六年九月三十日止三個月之未經審核業績：

業績摘要

ASMPT Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零二六年九月三十日止三個月（「二零二六年第三季度」）錄得來自持續經營業務之銷售收入為港幣 52.5 億元（6.69 億美元），按季增加 6.3%，按年亦增加 48.7%。集團二零二六年第三季度錄得來自持續經營業務之綜合除稅後盈利為港幣 5.33 億元，而上一季度錄得盈利為港幣 4.18 億元，二零二五年同期則錄得虧損為港幣 2.86 億元。（根據非香港財務報告會計準則計量經調整後為港幣 6.90 億元，按季增加 8.2%，按年亦增加 486.3%）。

來自持續經營業務的每股基本盈利為港幣 1.28 元，而上一季度每股基本盈利為港幣 1.01 元，二零二五年同期則錄得每股基本虧損為港幣 0.69 元。（根據非香港財務報告會計準則計量經調整後為港幣 1.65 元，按季增加 7.8%，按年亦增加 489.3%）。

管理層討論及分析

二零二六年第三季度的回顧將由業務亮點開始解說，接著是集團及其業務分部，即半導體解決方案分部（「SEMI」）及表面貼裝技術解決方案分部（「SMT」）的財務回顧。

二零二六年第三季度集團業務亮點

集團於二零二六年第三季度的新增訂單總額創新高，主要由於持續的人工智能基礎設施投資帶動對先進封裝（「AP」）、半導體解決方案分部主流業務及表面貼裝技術解決方案分部的需求。半導體解決方案分部需求主要受支援先進晶片封裝及光學連接的熱壓焊接（「TCB」）及光子帶動，而表面貼裝技術解決方案分部則持續受惠於對人工智能伺服器板及光學收發器的強勁需求。

先進封裝

集團的先進封裝組合在 TCB、光子及覆晶高精度固晶（「FC」）方面展現強勁的商業勢頭，並持續開發新一代封裝解決方案。

熱壓焊接 (TCB)

在邏輯方面，人工智能運算需求持續帶動客戶對集團 TCB 解決方案的強勁投資勢頭。晶片到基底（「C2S」）解決方案的訂單總額創新高，主要受領先先進邏輯客戶的外判半導體裝嵌及測試（OSAT）合作夥伴對更大型複合固晶 TCB 設備的強勁需求，以及其他與人工智能相關的先進封裝應用訂單所帶動。在晶片到晶圓（「C2W」）方面，集團獲得一家全球領先整合設備製造商（「IDM」）就支援客戶端運算和人工智能推理應用的先進中央處理器（CPUs）項目的重複訂單，反映客戶對 ASMPT 晶片到晶圓解決方案持續充滿信心。

在記憶體方面，客戶對購置新設備的決策時機仍與第四代高頻寬記憶體（HBM4）產品推出的時間表密切相關，符合先前預期。行業正重新評估記憶體密度、熱能管理與成本之間的最佳平衡，客戶亦正重新調整其投資時間表。儘管較大規模及以提升技術能力為導向的投資計劃有所延遲，但集團相信客戶對新增產能及選擇性提升技術的需求仍然存在。同時，集團正開發新一代 TCB 解決方案，旨在提供更卓越的產能、良率及工藝表現，從而進一步鞏固其競爭優勢，為把握下一階段高頻寬記憶體相關客戶的投資做好準備。

管理層討論及分析(續)

集團持續提升其面板級封裝能力，以滿足新一代產品對更高產能、更大可擴展性及更佳成本效益的需求。其四分之一面板解決方案已與一家領先先進邏輯客戶進行樣品焊接，同時，集團亦正為一家全球領先整合設備製造商開發用於嵌入式及表面矽橋晶粒架構的解決方案。這些合作將 ASMP 的 TCB 創新技術拓展至新興的面板級封裝領域，使集團得以在先進封裝架構演進過程中，把握新機遇。

光子

集團擁有涵蓋可插拔式光學收發器、近封裝光學（「NPO」）及共同封裝光學（「CPO」）的全面解決方案組合。受惠於 800G、1.6T 及新一代光學模組產量提升，以滿足人工智能相關應用對更快速及更高效的數據傳輸需求，半導體解決方案分部的光子新增訂單總額及銷售收入於二零二六年第三季度均創新高。

半導體解決方案分部的可插拔式光學收發器解決方案不僅獲得大量訂單，亦進一步鞏固其在收發器市場的領先地位。值得一提的是，其 AMICRA 業務在近封裝光學方面亦取得突破，成功獲得一家主要客戶的大額訂單。此外，AMICRA 的超高精度固晶解決方案首次獲得一家領先通訊服務供應商用於生產光學收發器的訂單。在共同封裝光學領域，集團持續深化與多家全球領先共同封裝光學企業的合作，進一步鞏固其市場布局，為把握加速採用共同封裝光學所帶來的增長機遇和為提升市場份額做好準備。這些進展共同體現了集團光子解決方案組合的覆蓋面之廣，並為集團創造長達數年的增長機遇。

覆晶高精度固晶 (FC)

集團用於大型固晶的覆晶高精度固晶解決方案受惠於客戶對高產能、大尺寸及具成本效益的組裝應用的需求，銷售收入持續錄得增長。隨著人工智能基礎設施及新一代運算平台的投資增加，這些解決方案正日益獲應用於定制化人工智能專用集成電路（「ASICs」）及先進扇出型晶圓級封裝。

混合式焊接（「HB」）

混合式焊接在三維集成電路（3D IC）、高頻寬記憶體及用於共同封裝光學的電子晶片與光子晶片（EIC-PIC）集成方面皆蘊藏龐大的機遇。集團的第二代混合式焊接解決方案在精確對正、焊接準確度、生產布局效率及產能方面皆具競爭力。集團持續與領先邏輯及記憶體客戶合作，有關項目目前處於採樣、評估及認證等不同階段。

管理層討論及分析(續)

半導體解決方案分部之主流業務

與人工智能相關的需求持續支持半導體解決方案分部之主流業務，尤其是數據中心的能源管理及人工智能伺服器主機板。隨著引線焊接（「WB」）及固晶鍵合（「DB」）設備受人工智能基礎設施擴張及外判半導體裝嵌及測試企業的高產能利用率所帶動，銷售收入及新增訂單總額維持於較高水平。

表面貼裝技術解決方案分部

表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額連續第三個季度創新高，並錄得歷來最高的新增訂單總額市場份額，需求主要受人工智能伺服器主機板及光學收發器推動。表面貼裝技術解決方案分部用於大型電路板組裝的具高靈活性解決方案，持續受惠於人工智能伺服器製造領域的強勁需求，該方案結合了小型及大型、重型組件的高速貼裝及具備高密度、多角度組裝和先進檢測能力，確保大規模生產下仍能提供卓越的良率、產能及可靠性。值得注意的是，在人工智能伺服器需求強勁帶動下，美洲的新增訂單總額增長進一步加快。

集團二零二六年第三季度財務回顧 – 持續經營業務

(港幣百萬元)	二零二六年第三季度	按季	按年
新增訂單總額*	8,845.1 (11.28 億美元)	+24.7%	+137.9%
銷售收入	5,247.0 (6.69 億美元)	+6.3%	+48.7%
經調整毛利率	42.9%	+35 點子	+517 點子
經調整經營利潤	922.4	+8.9%	+379.2%
經調整盈利	689.7	+8.2%	+486.3%
經調整盈利率	13.1%	+23 點子	+981 點子

* 新增訂單總額反映該季度內新取得的訂單

集團的銷售收入為港幣 52.5 億元（6.69 億美元），高於銷售收入預測的中位數，按季增長 6.3%，按年亦增長 48.7%，受半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部所推動。

受惠於人工智能基礎設施投資持續增加、一次性大額訂單以及交付週期延長促使客戶提前訂貨，集團於二零二六年第三季度的新增訂單總額創新高達港幣 88.5 億元（11.3 億美元）。在多種產品（尤其是 TCB、表面貼裝技術解決方案分部產品及光子）強勁需求帶動下，新增訂單總額按季增長 24.7%，按年亦增長 137.9%。集團訂單對付運比率達 1.69，為二零二一年第一季度以來最高水平。

集團經調整毛利率為 42.9%，按季上升 35 點子，按年亦上升 517 點子，主要受惠於表面貼裝技術解決方案分部及半導體解決方案分部毛利率的改善。

集團的經調整經營利潤為港幣 9.22 億元，按季上升 8.9%，按年亦上升 379.2%，歸因於高銷售收入及毛利率。經調整營運支出（「OPEX」）按季增加 6.0%，按年亦增加 16.6%，按季及按年增加均主要由於獎勵撥備及銷量增加。

集團經調整盈利為港幣 6.90 億元，受惠於經營利潤增加，按季增長 8.2%，按年亦增長 486.3%。

管理層討論及分析(續)

二零二六年第三季度半導體解決方案分部財務回顧 – 持續經營業務

(港幣百萬元)	二零二六年第三季度	按季	按年
新增訂單總額*	4,417.3 (5.63 億美元)	+31.3%	+156.3%
銷售收入	2,934.0 (3.74 億美元)	+1.5%	+68.0%
經調整毛利率	46.6%	+6 點子	+502 點子
經調整分部盈利	595.4	-1.3%	+620.9%
經調整分部盈利率	20.3%	-56 點子	+1,556 點子

* 新增訂單總額反映該季度內新取得的訂單

半導體解決方案分部於二零二六年第三季度的銷售收入為港幣 29.3 億元（3.74 億美元），按季增長 1.5%，按年亦增長 68.0%，佔集團總銷售收入約 56%。按年增長主要受惠於與人工智能相關應用的光子解決方案，以及用於人工智能和消費終端市場的引線及固晶機。

半導體解決方案分部的新增訂單總額為港幣 44.2 億元（5.63 億美元），按季增長 31.3%，按年亦增長 156.3%，為自二零二一年第一季度以來最高的季度新增訂單總額。人工智能帶動的需求為半導體解決方案分部產品組合提供廣泛支持，尤其是 TCB、光子及覆晶高精度固晶解決方案。

於二零二六年第三季度，半導體解決方案分部經調整毛利率為 46.6%，按季增加 6 點子，按年亦增加 502 點子。按年增長主要由銷量增加及有利的產品組合所帶動。

經調整分部盈利為港幣 5.95 億元，按季下跌 1.3%，按年則上升 620.9%。按季下跌是由於獎勵撥備增加，而按年增長則由於銷量增加及更佳的毛利率。

二零二六年第三季度表面貼裝技術解決方案分部財務回顧 – 持續經營業務

(港幣百萬元)	二零二六年第三季度	按季	按年
新增訂單總額	4,427.8 (5.65 億美元)	+18.9%	+122.1%
銷售收入	2,313.1 (2.95 億美元)	+13.2%	+29.8%
經調整毛利率	38.2%	+131 點子	+425 點子
經調整分部盈利	410.4	+44.1%	+143.2%
經調整分部盈利率	17.7%	+381 點子	+827 點子

表面貼裝技術解決方案分部錄得銷售收入為港幣 23.1 億元（2.95 億美元），按季增長 13.2%，按年亦增長 29.8%，其新增訂單總額連續三個季度創新高達港幣 44.3 億元，按季增長 18.9%，按年亦增長 122.1%。此強勁表現主要由強勁的人工智能伺服器需求，以及總值超過 1 億美元的大額訂單及客戶提前訂貨所帶動。

分部經調整毛利率為 38.2%，按季上升 131 點子，按年亦上升 425 點子。按季及按年增長均受惠於銷量增加。

經調整分部盈利為港幣 4.10 億元，受銷量增加所推動，按季增長 44.1%，按年亦增長 143.2%。

管理層討論及分析(續)

前景

集團預計二零二六年第四季度的銷售收入將介乎於 6.7 億美元至 7.3 億美元之間，以其中位數 7.0 億美元計按季增長 4.6%，按年亦增長 37.5%，高於市場預期。此增長將由表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入雙位數增長所帶動，而半導體解決方案分部的銷售收入則預計將因先進封裝產品交付週期較長而大致持平。

二零二六年第四季度的新增訂單總額在兩個業務分部持續受惠於人工智能基礎設施投資的支撐下，按年將維持於較高水平。集團預計第四季度的新增訂單總額，將低於第三季度因表面貼裝技術解決方案分部錄得的一次性大額訂單及提前訂貨所致的紀錄高位。

展望未來，預計於二零二七年與人工智能相關的需求將持續為銷售收入帶來增長動力。

財務概要

簡明綜合損益表

		截至 二零二六年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二六年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
	附註			
持續經營業務				
銷售收入	2	5,247,045	4,935,800	3,527,972
銷貨成本	3	(3,037,666)	(2,843,313)	(2,275,761)
毛利		2,209,379	2,092,487	1,252,211
其他收入		52,149	36,951	37,340
銷售及分銷費用		(482,256)	(450,946)	(379,418)
一般及行政費用		(350,639)	(304,679)	(299,583)
研究及發展支出		(577,913)	(550,388)	(492,621)
其他收益及虧損, 淨值		(5,644)	34,260	(15,802)
重組成本		(51,536)	(6,495)	(304,316)
其他支出		(17,263)	(199,945)	(27,938)
財務費用		(38,947)	(36,019)	(36,021)
聯營公司業績持份		34,400	30,092	–
合營公司業績持份		–	–	20,729
除稅前盈利(虧損)		771,730	645,318	(245,419)
所得稅開支		(238,511)	(227,475)	(40,781)
持續經營業務的本期間盈利(虧損)		533,219	417,843	(286,200)
終止經營業務				
終止經營業務的本期間(虧損)盈利		–	(85,570)	17,601
本期間盈利(虧損)		533,219	332,273	(268,599)
本公司持有人本期間應佔盈利(虧損):				
– 持續經營業務		533,219	420,706	(287,478)
– 終止經營業務		–	(85,570)	17,601
		533,219	335,136	(269,877)
非控股權益本期間應佔(虧損)盈利:				
– 持續經營業務		–	(2,863)	1,278
本期間盈利(虧損)		533,219	332,273	(268,599)

簡明綜合損益表 (續)

		截至 二零二六年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二六年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
	附註			
每股盈利(虧損) (持續經營業務及 終止經營業務)	4			
– 基本		港幣 1.28 元	港幣 0.80 元	港幣(0.65)元
– 攤薄		港幣 1.27 元	港幣 0.80 元	港幣(0.65)元
每股盈利(虧損) (持續經營業務)	4			
– 基本		港幣 1.28 元	港幣 1.01 元	港幣(0.69)元
– 攤薄		港幣 1.27 元	港幣 1.00 元	港幣(0.69)元

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二六年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二六年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利 (虧損)	533,219	332,273	(268,599)
其他全面 (支出) 收益			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
– 其他全面收益以公平價值列賬的權益性 工具投資之公平價值(虧損)收益淨額	(14)	(2,096)	11
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
– 換算海外營運公司匯兌差額			
– 附屬公司	27,425	13,888	(99,035)
– 聯營公司	10,500	35,961	–
– 合營公司	–	–	(6,021)
– 出售/視為出售附屬公司時累計匯兌儲備 進行重新分類	–	7,947	–
– 被指定對沖現金流的對沖工具之公平價值 收益	15,998	13,206	10,322
本期間其他全面收益 (支出)	53,909	68,906	(94,723)
本期間全面收益 (支出) 總額	587,128	401,179	(363,322)
以下各方本期間應佔全面收益(支出) 總額:			
本公司持有人	587,128	402,341	(364,471)
非控股權益	–	(1,162)	1,149
	587,128	401,179	(363,322)
本公司持有人本期間應佔全面收益(支出) 總額:			
– 持續經營業務	587,128	489,627	(372,345)
– 終止經營業務	–	(87,286)	7,874
	587,128	402,341	(364,471)

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，惟於各報告期期末按公平價值計量之若干金融工具除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團有兩個（二零二五年：兩個）經營分部：研究及發展、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。它們代表由集團製造的兩個（二零二五年：兩個）主要產品系列。

本集團以可報告之經營分部分析銷售收入和業績如下：

	截至 二零二六年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二六年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
持續經營業務			
對外客戶分部銷售收入			
半導體解決方案	2,933,990	2,891,949	1,746,610
表面貼裝技術解決方案	2,313,055	2,043,851	1,781,362
	5,247,045	4,935,800	3,527,972
分部業績			
半導體解決方案	505,145	564,184	(13,608)
表面貼裝技術解決方案	397,966	276,909	162,983
	903,111	841,093	149,375
利息收入	29,832	24,703	20,817
財務費用	(38,947)	(36,019)	(36,021)
聯營公司業績持份	34,400	30,092	—
合營公司業績持份	—	—	20,729
未分配其他收入	8,466	6,447	6,908
未分配外幣淨匯兌（虧損）收益及 外幣遠期合約的公平價值變動	(6,158)	23,110	(17,741)
未分配一般及行政費用	(90,728)	(50,065)	(57,920)
未分配其他收益	553	12,397	688
重組成本	(51,536)	(6,495)	(304,316)
未分配其他支出	(17,263)	(199,945)	(27,938)
除稅前盈利（虧損）	771,730	645,318	(245,419)
分部盈利率			
半導體解決方案	17.2%	19.5%	-0.8%
表面貼裝技術解決方案	17.2%	13.5%	9.1%

3. 銷貨成本

截至二零二六年九月三十日止三個月，本集團就二零二六年第三季度期內進行的重組項目作出一次性存貨撥備 / 註銷為港幣 3,140 萬元（二零二五年：港幣 7,390 萬元）。

4. 每股盈利 (虧損)

持續經營業務

來自持續經營業務之本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)乃根據下列數據計算：

	截至 二零二六年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二六年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核) (重列)
本公司持有人應佔本期間盈利(虧損) (持續經營業務及終止經營業務)	533,219	335,136	(269,877)
減：終止經營業務本期間(虧損)盈利	—	(85,570)	17,601
計算每股基本及攤薄盈利之盈利(虧損) (本公司持有人應佔之本期間盈利(虧損))	533,219	420,706	(287,478)
	截至 二零二六年 九月三十日 止三個月 股份數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二六年 六月三十日 止三個月 股份數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二五年 九月三十日 止三個月 股份數量 (以千位計) (未經審核)
計算每股基本盈利(虧損)之普通股 加權平均股數	417,791	417,785	416,202
潛在攤薄影響之股數： — 僱員股份獎勵計劃	1,349	1,007	1,268
計算每股攤薄盈利(虧損)之普通股 加權平均股數	419,140	418,792	417,470

截至二零二五年九月三十日止三個月，由於潛在普通股具有反攤薄效應，故計算每股攤薄虧損時並無將其納入，因此每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

4. 每股盈利 (續)

終止經營業務

截至二零二六年六月三十日止三個月，基於終止經營業務於本期間虧損約港幣 85,570,000 元並以上文詳述用於計算每股基本虧損的分母計算，終止經營業務之每股基本虧損及每股攤薄虧損均為港幣 0.20 元。在計算截至二零二六年六月三十日止三個月期間終止經營業務的每股攤薄虧損時，並無假設僱員股份獎勵計劃下潛在股份的影響，因有關影響將導致終止經營業務的每股虧損減少。

截至二零二五年九月三十日止三個月，基於終止經營業務於本期間盈利約港幣 17,601,000 元並以上文詳述用於計算每股基本盈利及每股攤薄盈利的分母計算，終止經營業務之每股基本盈利及每股攤薄盈利均為港幣 0.04 元。

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬

就財務表現回顧，集團已提供經調整業績及經調整每股盈利，作為集團根據香港財務報告會計準則呈列的綜合業績之補充。集團相信，上述額外數據能為股東及投資者提供有關集團持續經營表現的有用補充資料，有助分析及比較各期間的財務趨勢及業績。經調整盈利及經調整每股盈利不包括（i）以股份為基礎的支出，（ii）主要與僱員遣散費用及福利安排和停工相關成本的重組成本，（iii）因重組而產生的一次性存貨撥備／註銷，（iv）視作出售一家非全資擁有的附屬公司晟盈半導體設備（江蘇）有限公司（「SWAT」）的虧損，（v）或有代價調整收益，（vi）商譽及無形資產減值損失，及（vii）相關所得稅影響。

根據集團僱員股份獎勵計劃以股份為基礎的支出已計入香港財務報告會計準則報告中。至於非香港財務報告會計準則之計量，為使各期間的經營業績更具可比性，該項支出已予以排除。管理層認為，以股份為基礎的支出之金額可能因授予時間、歸屬期或市場價格波動而有所不同，剔除將有助於提高各期間經營業績的可比性。

採用該等非香港財務報告會計準則計量作為分析及比較工具或存在一定的局限性。故建議股東及投資者不應將其與集團根據香港財務報告會計準則所呈報的財務業績分開考慮或視作替代分析。此外，該等非香港財務報告會計準則計量的定義可能有別於其他公司使用的類似詞彙。

下表載列集團根據香港財務報告會計準則編製的二零二六年第三季度、二零二六年第二季度及二零二五年第三季度財務計量與非香港財務報告會計準則計量的對賬。

	三個月止		
	二零二六年 第三季度 港幣千元 (未經審核)	二零二六年 第二季度 港幣千元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 港幣千元 (未經審核) (重列)
持續經營業務			
毛利	2,209,379	2,092,487	1,252,211
非香港財務報告會計準則調整：			
– 以股份為基礎的支出	7,884	5,387	3,436
– 一次性存貨撥備/註銷	31,373	–	73,884
經調整毛利	2,248,636	2,097,874	1,329,531
毛利率	42.1%	42.4%	35.5%
經調整毛利率	42.9%	42.5%	37.7%
經營利潤	798,571	786,474	80,589
非香港財務報告會計準則調整			
– 以股份為基礎的支出	92,406	60,502	38,017
– 一次性存貨撥備/註銷	31,373	–	73,884
經調整經營利潤	922,350	846,976	192,490

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬(續)

	三個月止		
	二零二六年 第三季度 港幣千元 (未經審核)	二零二六年 第二季度 港幣千元 (未經審核)	二零二五年 第三季度 港幣千元 (未經審核) (重列)
<u>持續經營業務</u>			
盈利(虧損)	533,219	417,843	(286,200)
非香港財務報告會計準則調整:			
– 以股份為基礎的支出	92,406	60,502	38,017
– 重組成本	51,536	6,495	304,316
– 一次性存貨撥備/註銷	31,373	–	73,884
– 視作出售一家附屬公司 (SWAT) 之虧損	–	152,519	–
– 或然代價調整之收益	–	(11,418)	–
– 商譽及無形資產減值損失	–	21,985	–
– 相關所得稅之影響	(18,796)	(10,398)	(12,377)
經調整盈利	689,738	637,528	117,640
經調整盈利率	13.1%	12.9%	3.3%
經調整每股基本盈利	港幣 1.65 元	港幣 1.53 元	港幣 0.28 元

香港財務報告會計準則計量與非香港財務報告會計準則計量之對賬(續)

下表載列集團半導體解決方案（「SEMI」）及表面貼裝技術解決方案（「SMT」）根據香港財務報告會計準則編製的二零二六年第三季度、二零二六年第二季度及二零二五年第三季度財務計量與非香港財務報告會計準則計量的對賬。

	三個月止					
	二零二六年第三季度		二零二六年第二季度		二零二五年第三季度	
	半導體 解決方案	表面貼裝技 術解決方案	半導體 解決方案	表面貼裝技 術解決方案	半導體 解決方案	表面貼裝技 術解決方案
	港幣千元 (未經審核)	港幣千元 (未經審核)	港幣千元 (未經審核)	港幣千元 (未經審核)	港幣千元 (未經審核) (重列)	港幣千元 (未經審核) (重列)
持續經營業務						
毛利	1,327,334	882,045	1,339,784	752,703	648,420	603,791
非香港財務報告會計準則 調整:						
– 以股份為基礎的支出	7,408	476	5,072	315	3,202	234
– 一次性存貨撥備/註銷	31,373	–	–	–	73,884	–
經調整毛利	1,366,115	882,521	1,344,856	753,018	725,506	604,025
毛利率	45.2%	38.1%	46.3%	36.8%	37.1%	33.9%
經調整毛利率	46.6%	38.2%	46.5%	36.8%	41.5%	33.9%
分部盈利(虧損)	505,145	397,966	564,184	276,909	(13,608)	162,983
非香港財務報告會計準則 調整:						
– 以股份為基礎的支出	58,843	12,472	38,972	7,933	22,309	5,751
– 一次性存貨撥備/註銷	31,373	–	–	–	73,884	–
經調整分部盈利	595,361	410,438	603,156	284,842	82,585	168,734
分部盈利率	17.2%	17.2%	19.5%	13.5%	-0.8%	9.1%
經調整分部盈利率	20.3%	17.7%	20.9%	13.9%	4.7%	9.5%

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二六年九月三十日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：Bassel Haddad 先生及許一帆女士。

承董事會命
董事
Bassel Haddad

香港, 二零二六年十月二十七日

(本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。)